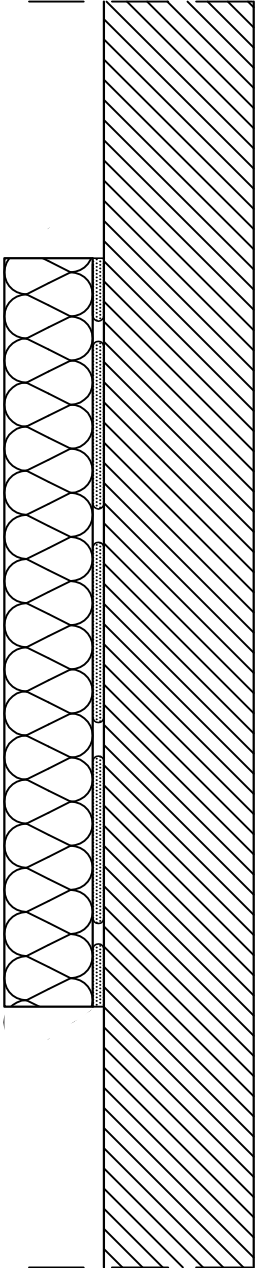
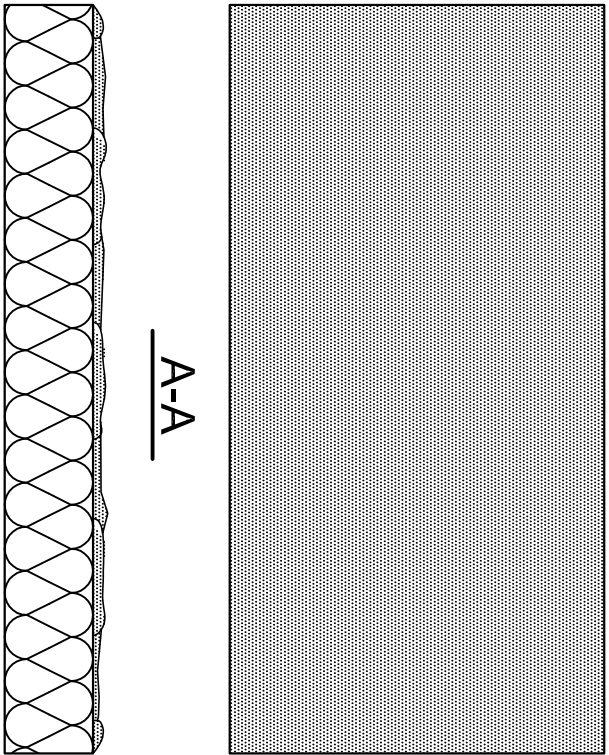
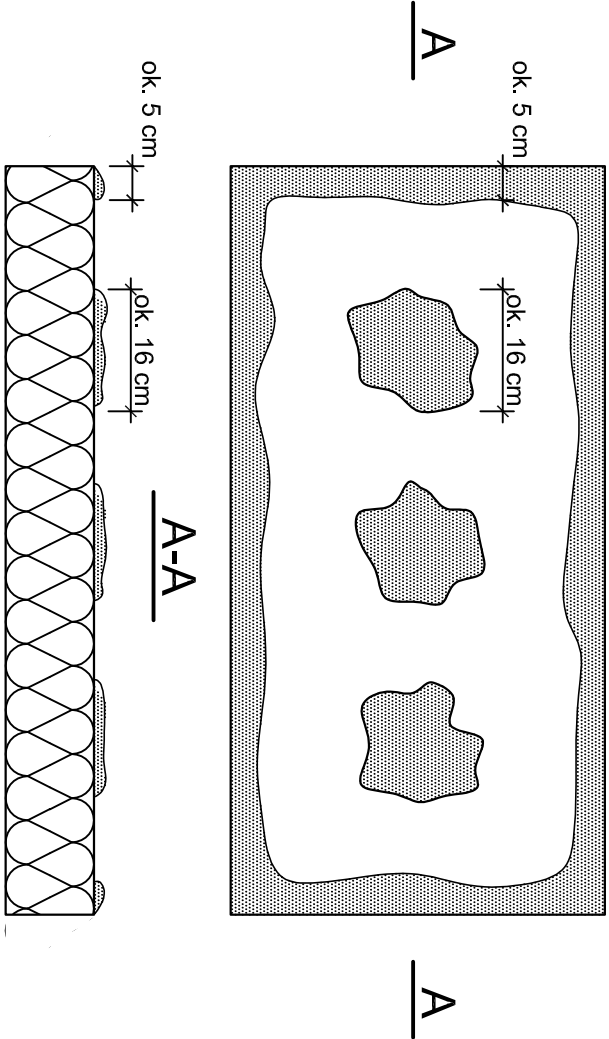
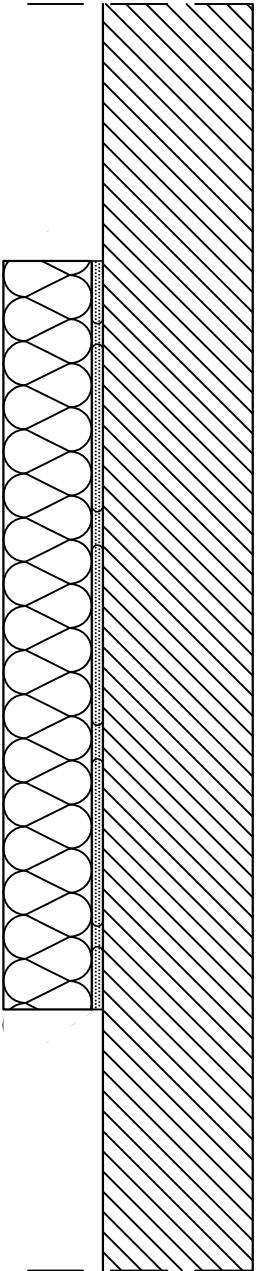


SPOSÓB KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ

stropian



wetna mineralna



Uwagi!

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwych i drewnopochodnych lub zapraw klejowych do zmiészania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje/karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmiészania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płycie nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejania płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowane grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płycie termozolajną całopowierzchniowo przy użyciu pasy zembatej (ok. 10mm).

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne!

Uwagi!

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwych i drewnopochodnych lub zapraw klejowych do zmiészania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych. Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje/karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmiészania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody całopowierzchniowej metodą grzbieńową. Na płycie nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejania płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowane grubości izolacji).

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne!

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>EkoProBuD</div><div><small>Instytut Projektowania i Budownictwa</small></div></div></div><div><div><div></div><div>EkoProBuD</div><div><small>Instytut Projektowania i Budownictwa</small></div></div></div></div><div><div><div>Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65</div><div>tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl</div></div></div></div></div>			
ADRES INWESTYCJI:		Budynek mieszkalny wielorodzinny	
Tytuł:		PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PRZYJAŹNI 2 W BĘDZINIE	
Tytuł rysunku:		SPOSÓB KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ	
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. L. Właniński nr upr. 74387	PODPIS:	11-2017
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Ł. Wengler nr upr. 6710/SŁOKK	PODPIS:	SKALA: 1:10
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Monika Leszczyńska	PODPIS:	NR RYS. 6
MEROWNIK BIURA:	dr inż. T. Muzyczuk	PODPIS:	